

技術紹介

5 携帯機器向け平行基板間接続用コネクタの開発

Development of Board to Board Connector for Mobile Devices

石川 哲弥 Tetsuya Ishikawa コネクタ開発本部

キーワード connector, 小型、携帯電話、耐振性、耐衝撃性
Keywords connector, small size, mobile phone, vibration proof, shock proof

■ 要旨

携帯機器の小型化、高機能化に伴い、高密度実装が進み、これらの機器に実装されるコネクタも低背化、小面積化が要求されています。また、持ち運ばれる機器であることから、耐衝撃・振動性も要求されます。

携帯機器内で使用される平行基板間接続用コネクタは、各社とも製品を世の中に提供していますが、いくつかの問題点を抱えています。当社では、上述の要求に対応し、且つ、これまでありました問題点を解決するべく考慮された、平行基板間接続用コネクタを開発しました。

■ SUMMARY

With the progress of high-density packaging of the mobile devices in order to achieve downsizing and to enhance performance, connectors used for such applications are requested to be lower profile and smaller dimension. Also, since such devices are always carried by users, robustness to vibration and shock is also important.

Many makers are now supplying the parallel board to board connectors mounted in the mobile devices, but they still have some problems to be solved. JAE succeeded in development of the board to board connector, which satisfies the requirements above while settling the problems of the existing connectors.

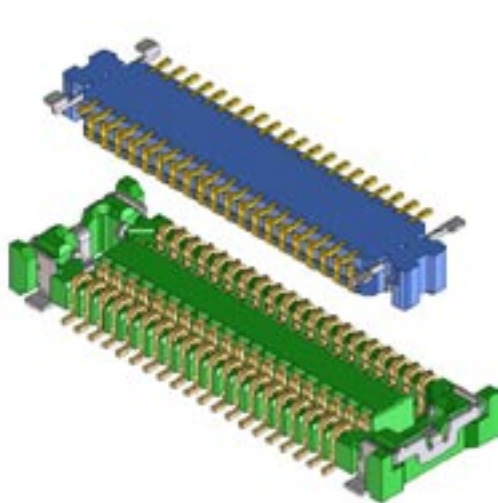


図1 AA01A コネクタ

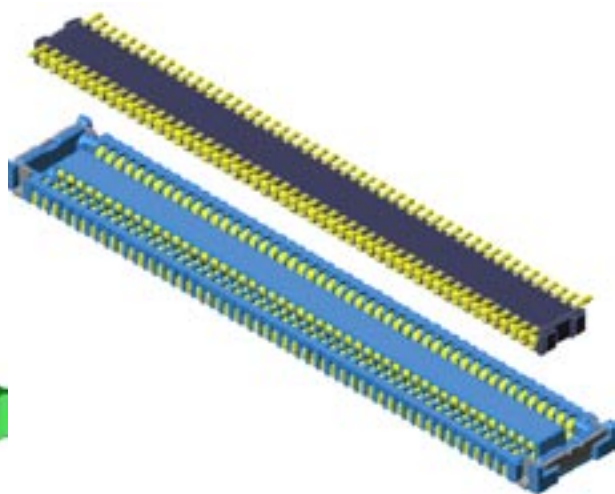


図2 AA03 コネクタ